

Product Lineup

Thermalnite®

▶ Thermalnite®

特徴：纖維長 D50、14μm程度
纖維径 D50、3.2μm程度

用途：放熱シート、封止樹脂、
接着剤、ギャップフィラー、
熱可塑性樹脂

▶ Thermalnite® 粉体

特徴：纖維長D50、10μm程度
纖維径 D50、2.7μm程度

用途：グリース、接着剤、
アンダーフィル

※上記製品に表面処理や耐水処理を施すことも可能

放熱シート

▶ 低熱抵抗放熱シート

厚み：0.1, 0.2, 0.5, 1.0mm
サイズ：A4・A5
応用製品：コントローラー、電源、
光トランシーバー、SSD、LED、
LD、など

▶ 高熱伝導放熱シート

厚み：0.5, 1.0mm
応用製品：パワーモジュール、
モータードライブユニット、
通信モジュールIC、CPU、など

ハイブリッドフィラー



▶ ハイブリッドフィラー 小粒子

特徴：Thermalnite短纖維
+ 球状AIN、最大粒径80μm
用途：封止樹脂、接着剤、グリース、
ギャップフィラー、熱可塑性樹脂

▶ ハイブリッドフィラー 大粒子

特徴：Thermalnite短纖維
+ 球状AIN、最大粒径300μm
用途：ギャップフィラー、封止樹脂、
熱可塑性樹脂

※上記製品に表面処理を施すことも可能

セラミックス基板

▶ 高強度AIN基板（面内配向品）

熱伝導率：170, 200,
230W/m・K（開発品）
厚み：0.2~1mm
サイズ：□4.5inch
用途：パワーモジュール、
LED/LDモジュール、など

